

株式会社 東京精密 2017年度(平成30年3月期) 決算説明会

2018年5月15日

◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 新 中期目標
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ 質疑応答

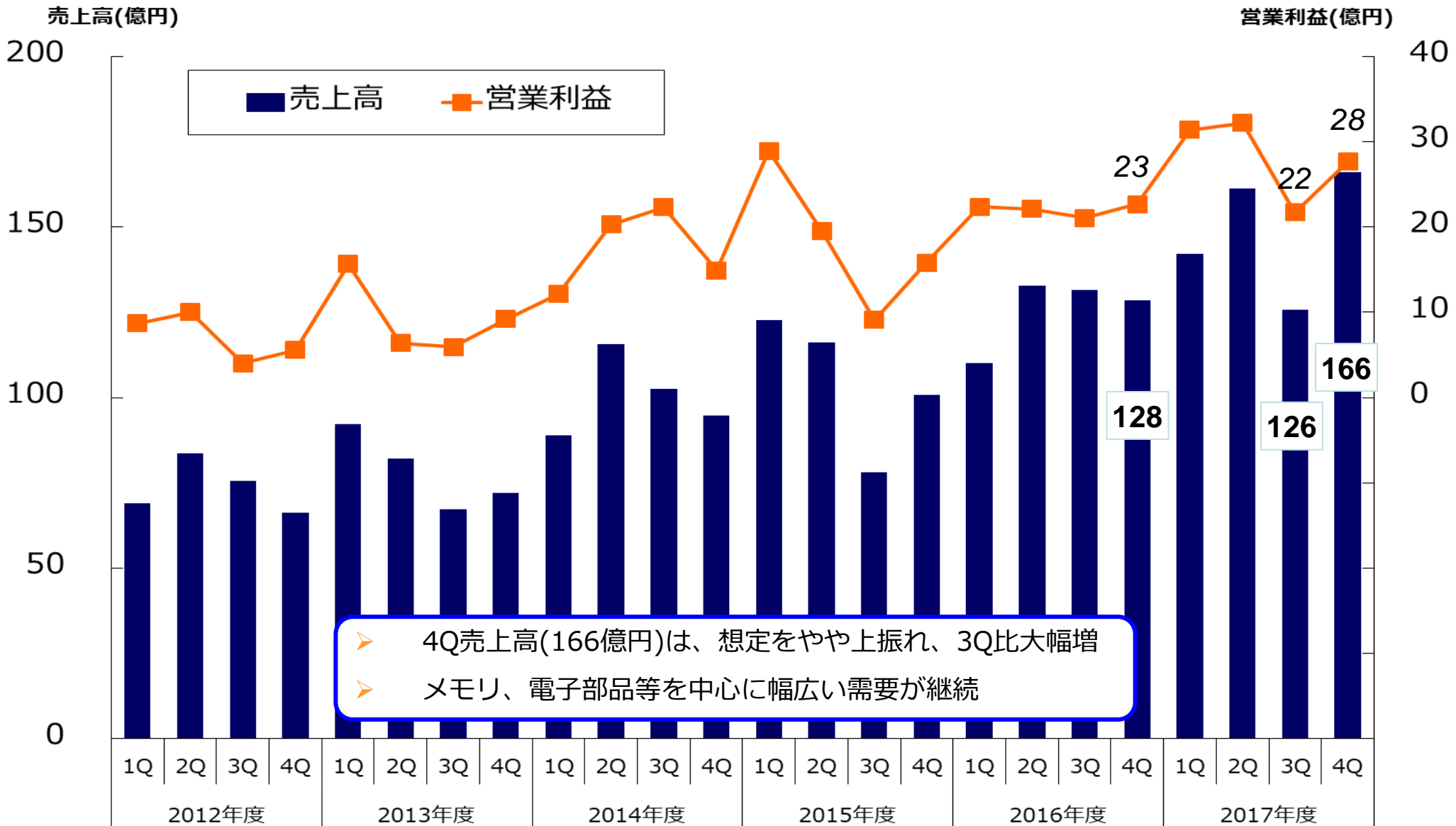
単位：億円

	2016年度	2017年度	
	通期実績	通期実績	前期比
売上高	778	882	+13%
半導体製造装置	503	595	+18%
計測機器	275	287	+4%
営業利益	137	173	+27%
半導体	88	113	+28%
同率	18%	19%	-
計測	48	60	+24%
同率	18%	21%	-
経常利益	139	173	+25%
<small>親会社株主に帰属する</small> 当期純利益	99	127	+28%
1株配当	72円	92円	+20円

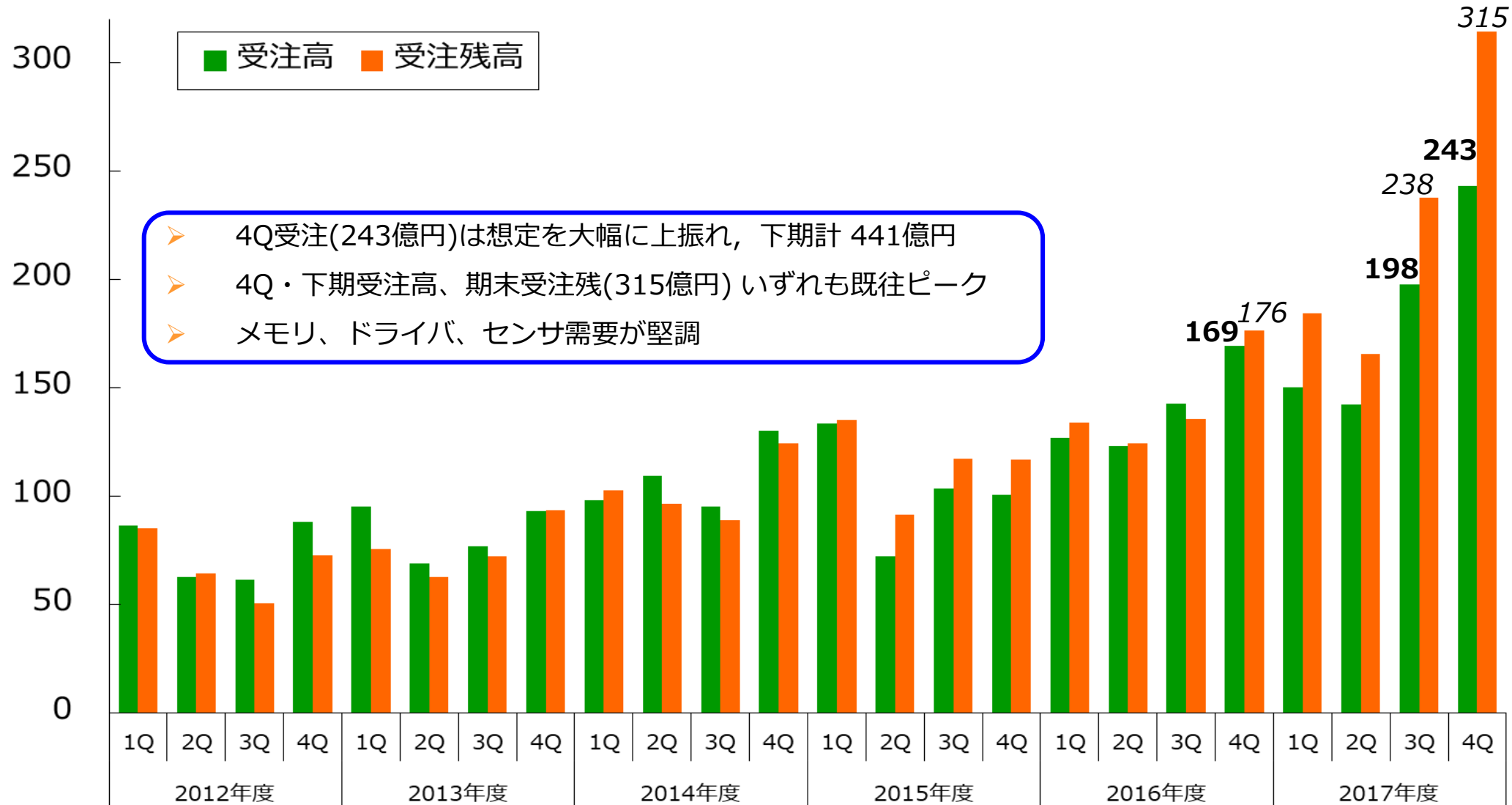
単位: 億円

	2016年度				2017年度					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
売上高	163	209	195	211	199	238	192	253	+31%	+20%
半導体	110	133	132	128	142	161	126	166	+32%	+29%
計測	53	76	63	83	57	76	67	87	+30%	+5%
営業利益	29	37	32	39	40	49	36	48	+32%	+21%
半導体	22	22	21	23	31	33	22	28	+27%	+22%
同率	20%	17%	16%	18%	22%	20%	17%	17%		
計測	6	15	11	16	9	16	14	20	+38%	+21%
同率	12%	20%	17%	20%	16%	22%	22%	23%		
経常利益	26	37	35	41	41	49	36	46	+27%	+14%
親会社株主に帰属する 当期純利益	19	28	14	39	29	35	26	38	+44%	-3%

半導体 - 売上高, 営業利益

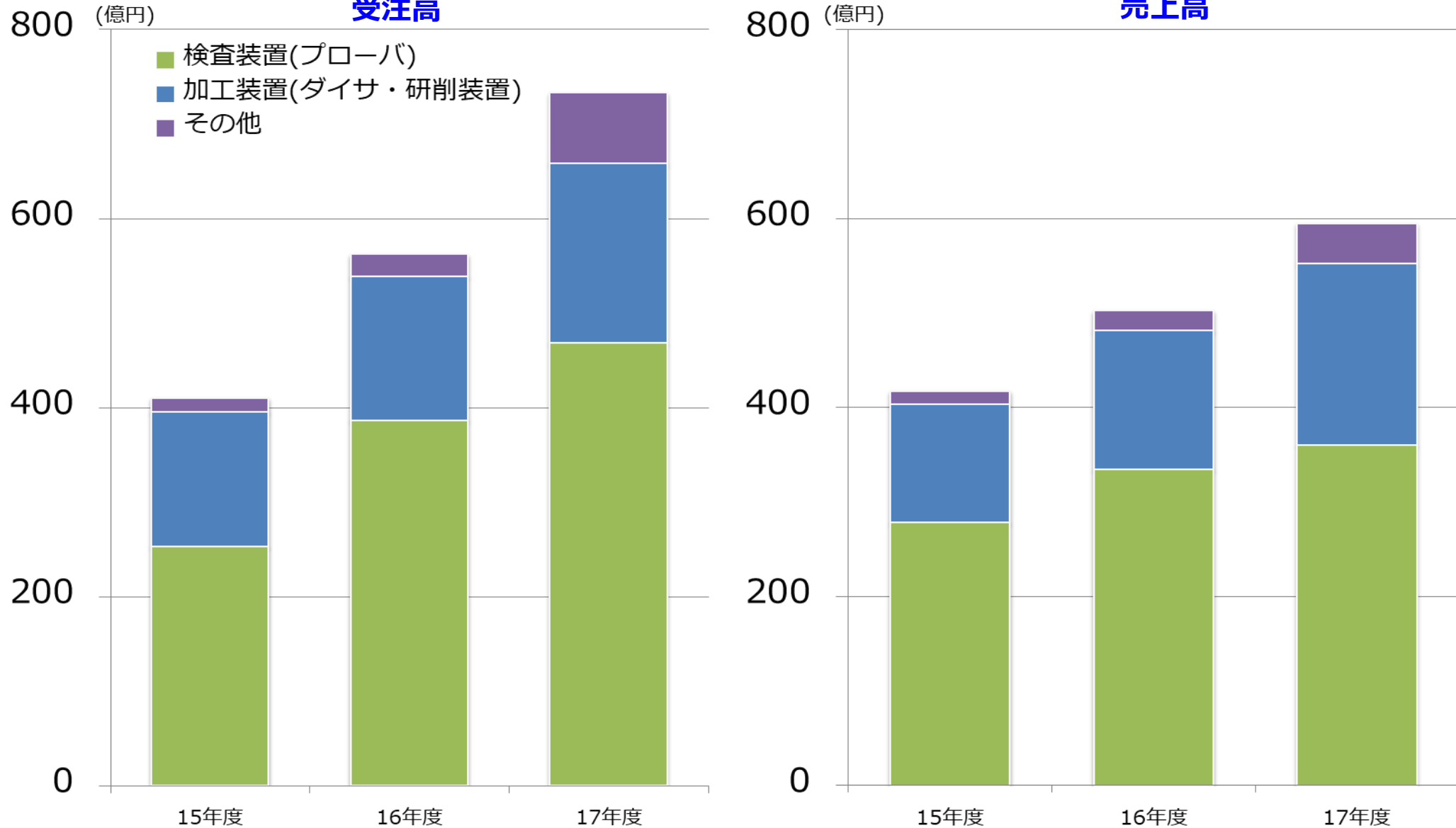


(億円)

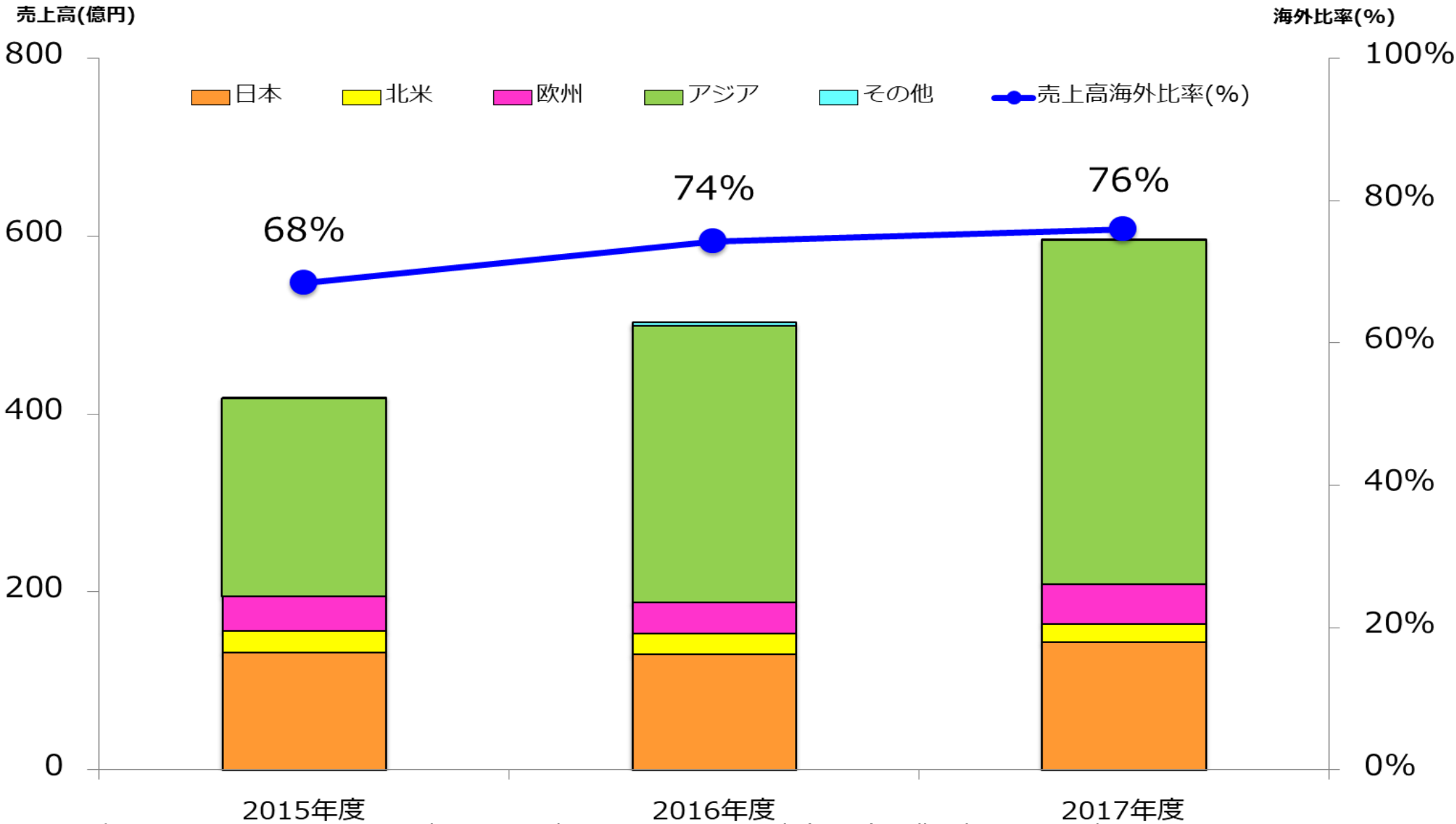


受注高

売上高

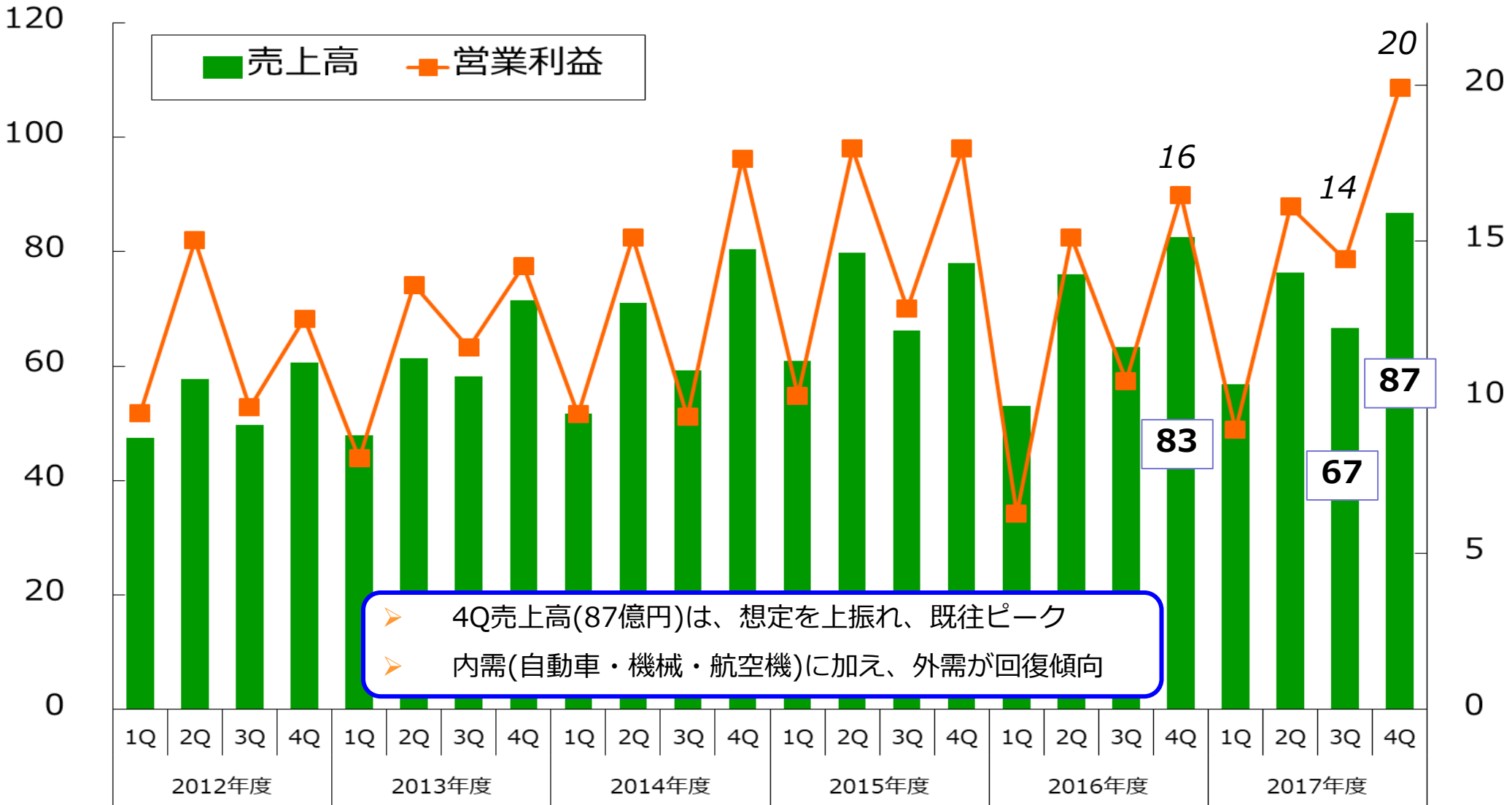


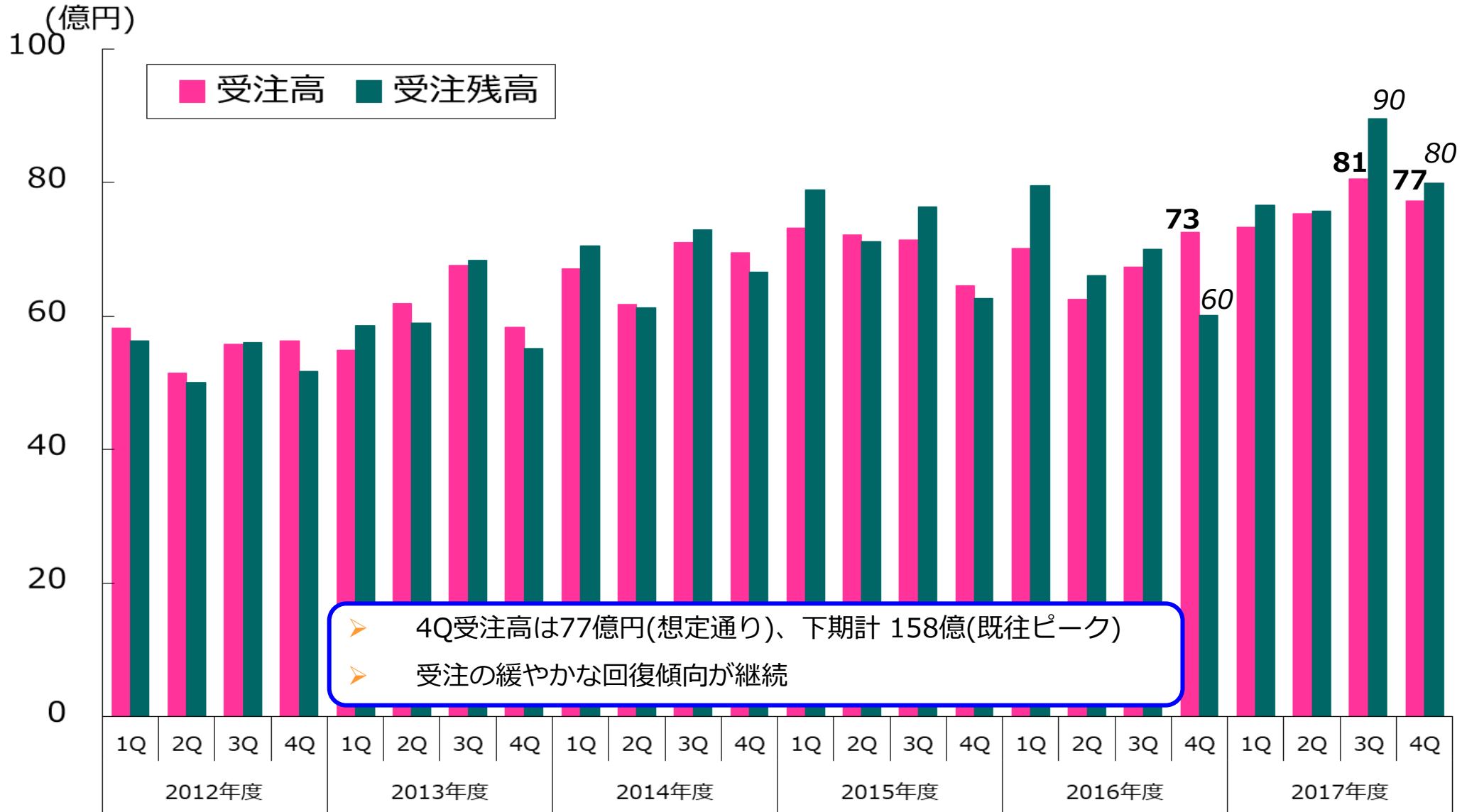
半導体 - 地域別売上高

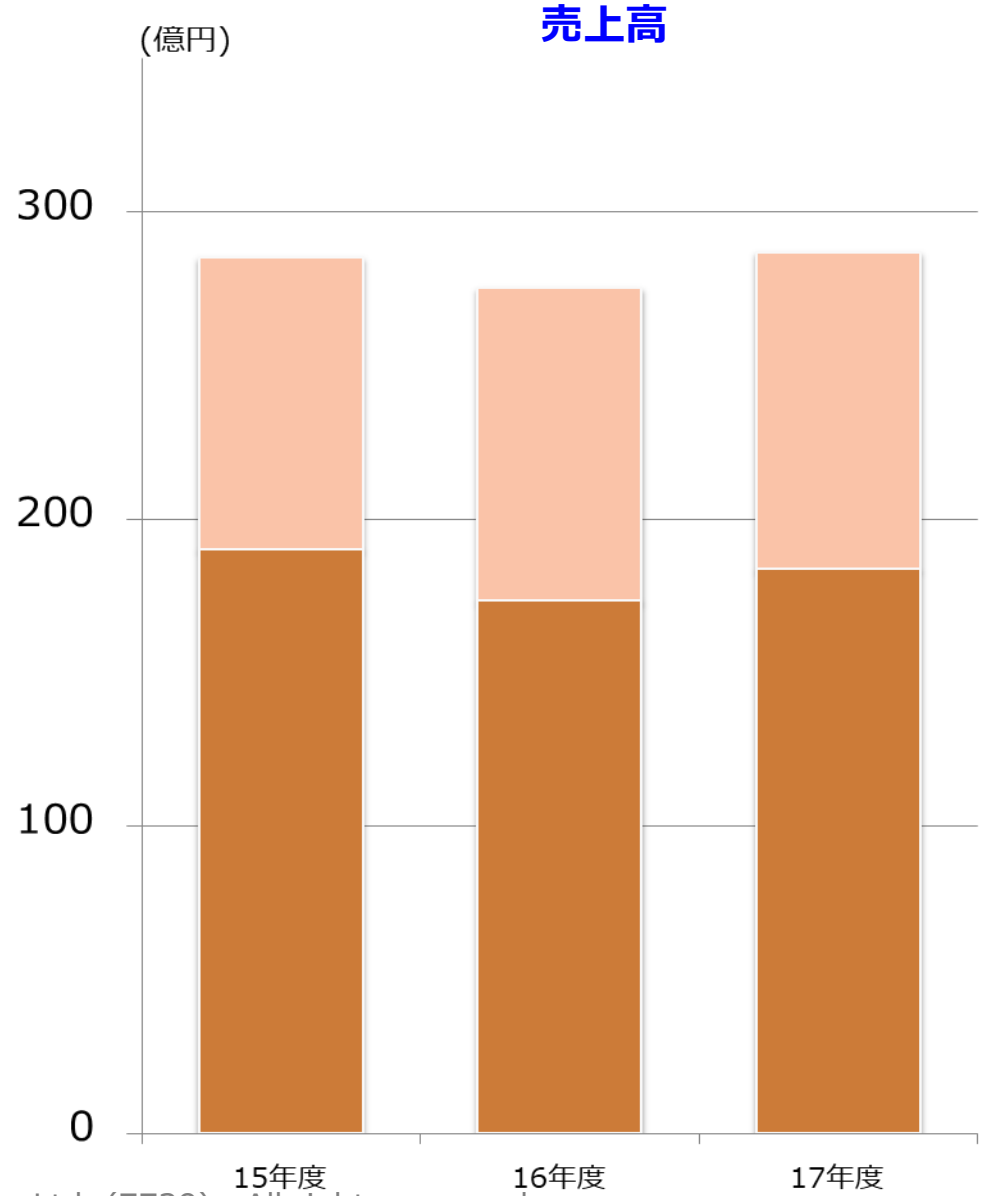
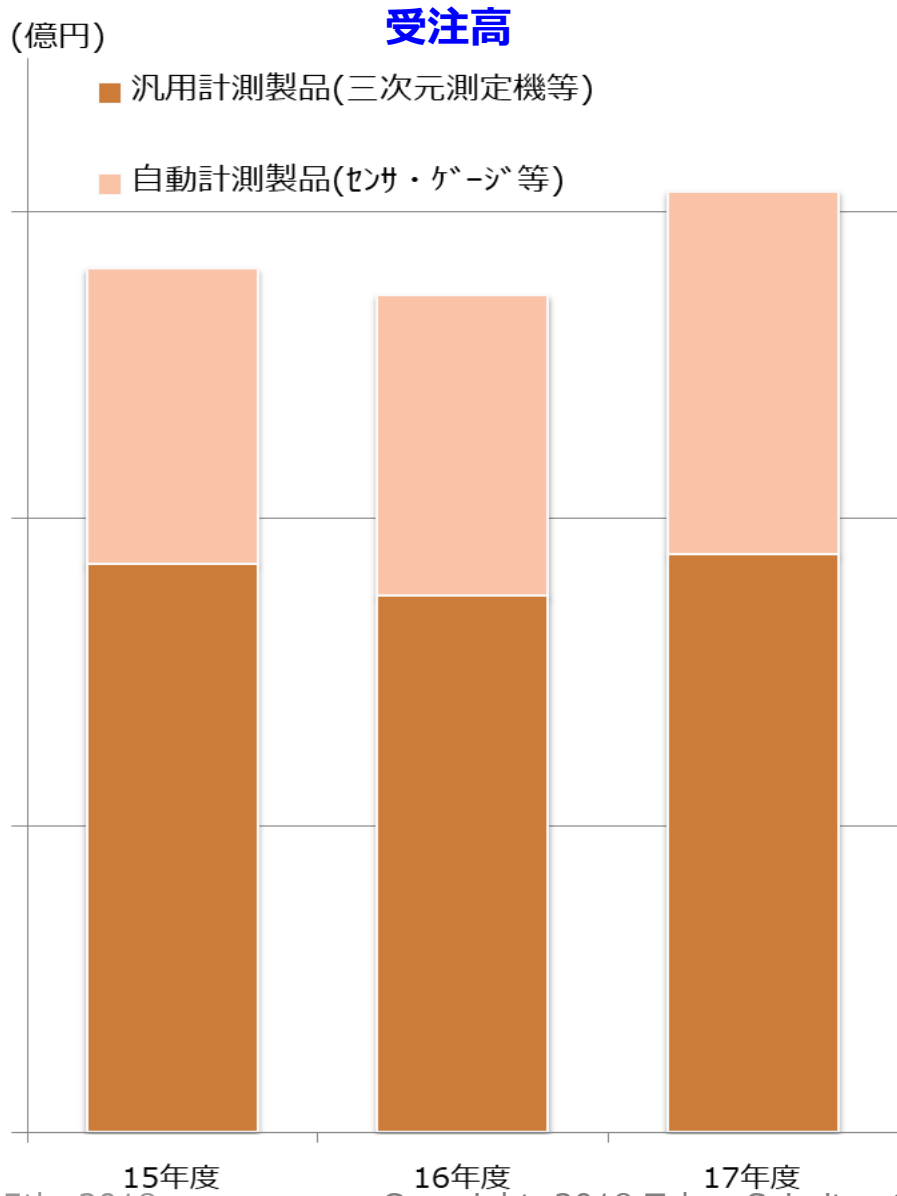


売上高(億円)

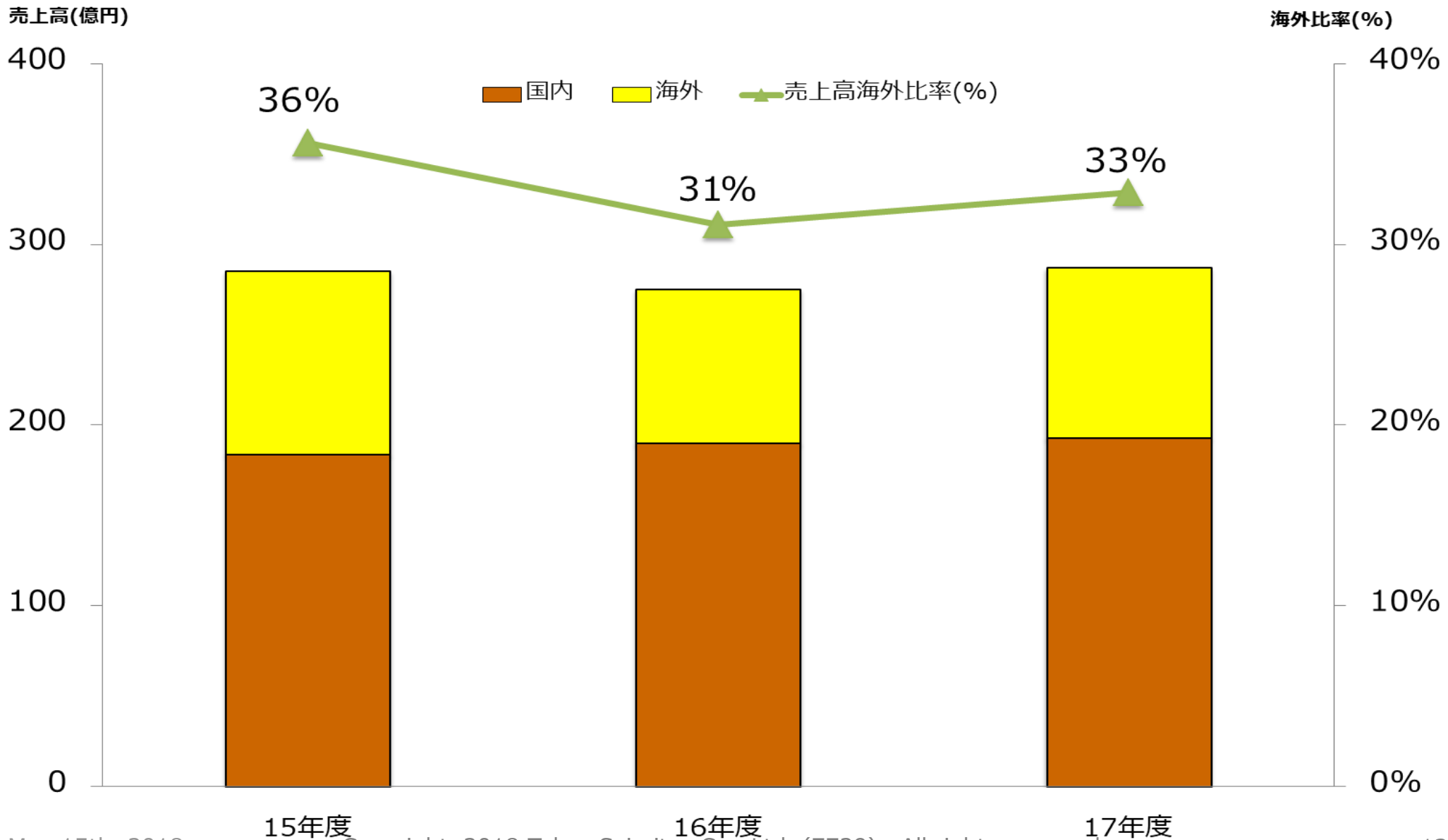
営業利益(億円)







計測 - 地域別売上高

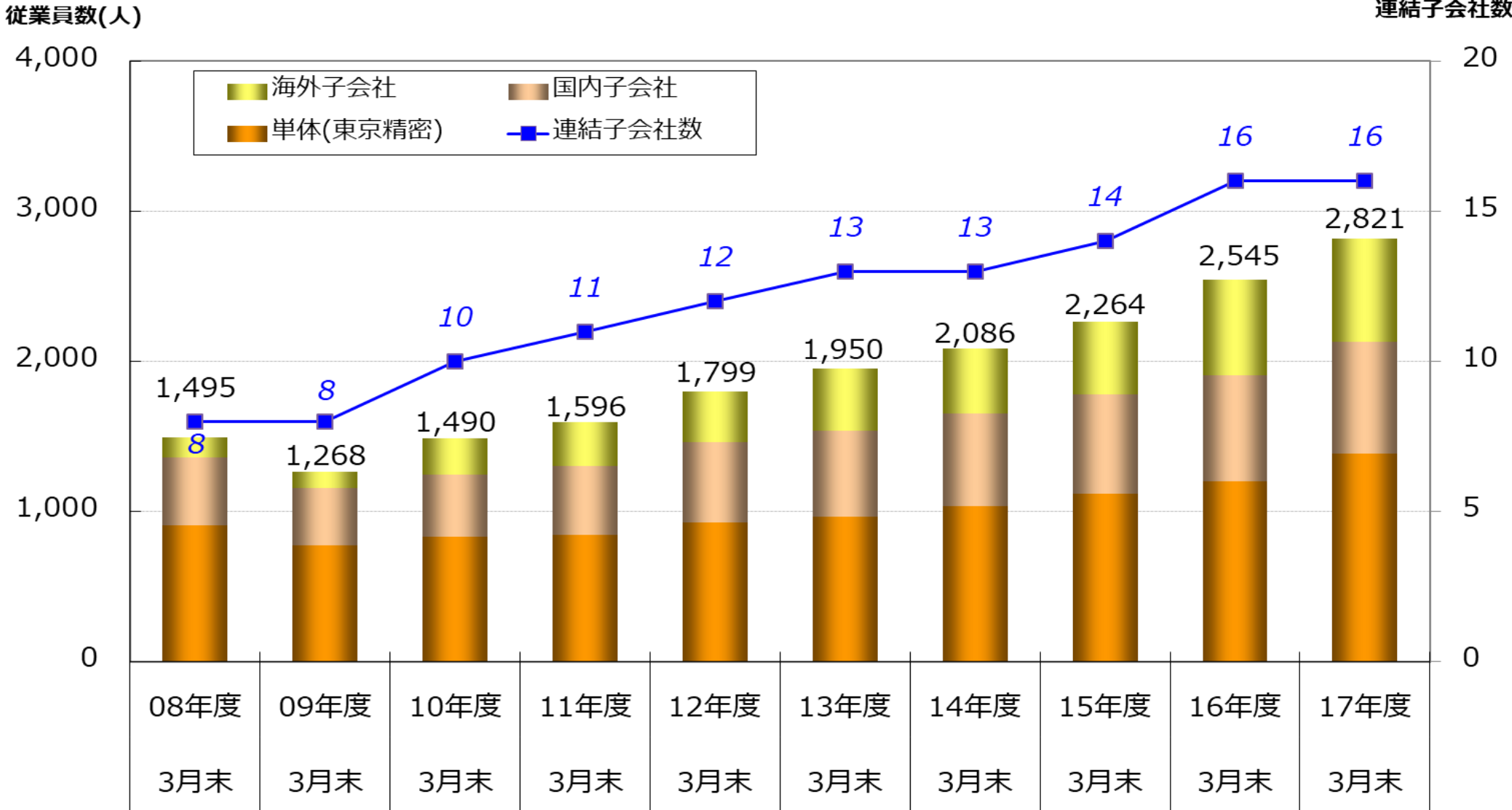


2017年度 貸借対照表

資産 (億円)	17/3末	18/3末	増減	負債/純資産 (億円)	17/3末	18/3末	増減
現預金	339	372	+34	支手・買掛金, 電子記録債務	158	219	+61
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	284	334	+50	短期借入金	13	13	±0
在庫	173	223	+50	その他	95	96	+1
その他	32	34	+1	流動負債計	266	328	+62
流動資産計	828	963	+136	固定負債計	7	8	+1
固定資産計	317	366	+50	負債計	273	336	+64
資産合計	1,145	1,330	+185	純資産	872	994	+122
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,145 (13)	1,330 (13)	+185 (±0)

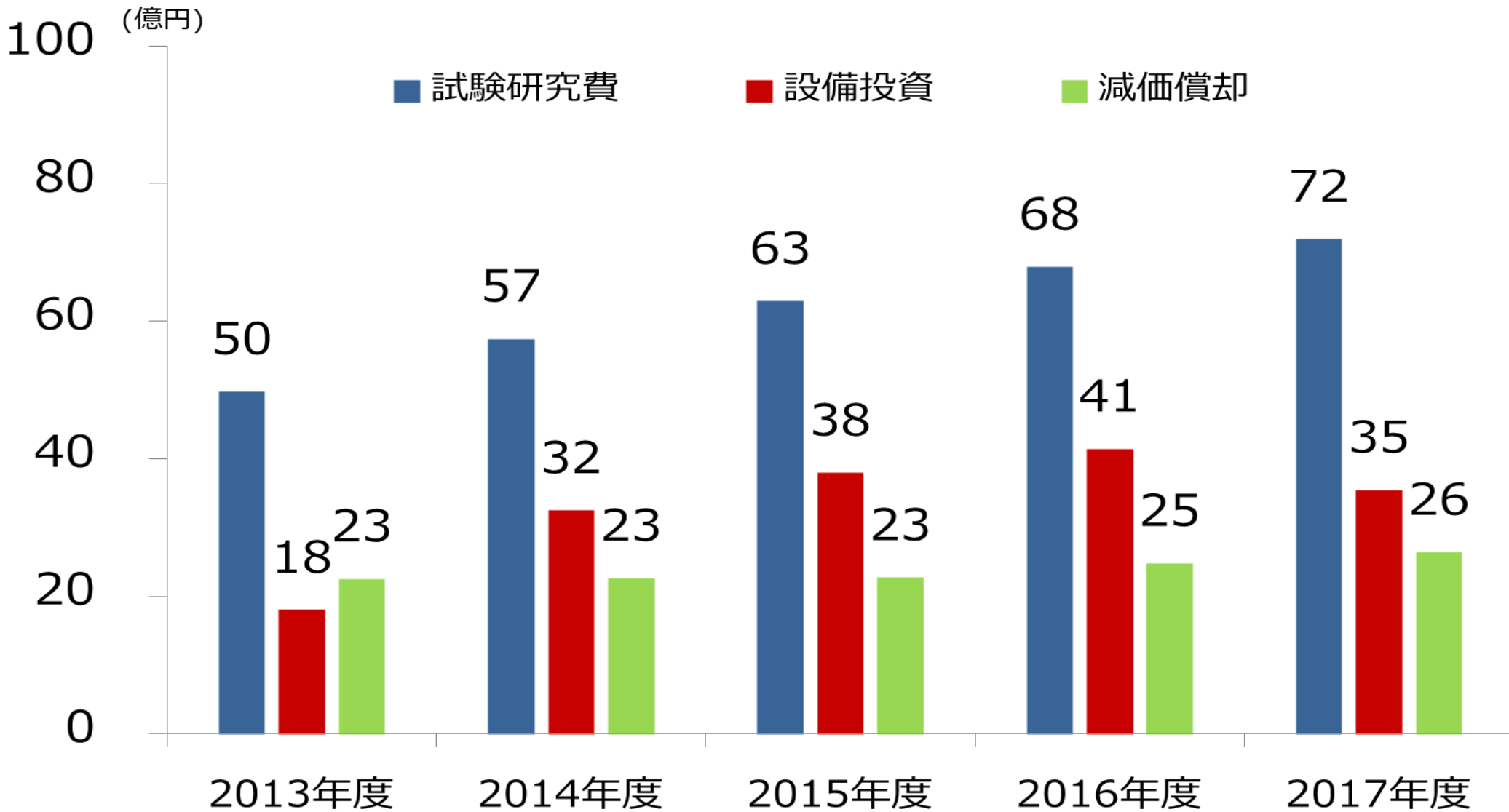
		単位：億円		
		2015年度	2016年度	2017年度
現金等 期首残高		268	273	338
営業活動	税引前・償却前利益	155	169	200
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	- 42	- 1	- 42
	納税	- 38	- 36	- 59
	その他	- 3	- 4	11
小計		72	128	109
投資活動		- 38	- 35	- 46
フリーキャッシュフロー		34	93	63
財務活動	社債・借入	- 5	- 3	- 0
	株式・配当金、他	- 23	- 26	- 31
	小計	- 28	- 30	- 32
増減額(含 換算差額・連結範囲変更)		+ 5	+ 65	+ 33
現金等 期末残高		273	338	371

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算

試験研究費,設備投資,減価償却



次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ **中期目標の進捗**
- ◆ 新 中期目標
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ 質疑応答

企業理念実現のための枠組み主な実績
(~ 2017年度)業績拡大・
企業価値
向上

成長投資

強固な財務基盤

CSR・
内外グループガバナンス

- ✓ 5期連続増収・増益
- ✓ ROE12~13% (>資本コスト)
- ✓ 内外アプリケーションセンター 新設・拡張
- ✓ 八王子第6工場、刈・消耗品工場竣工
- ✓ 研究開発投資拡大
- ✓ プラスマダイニング 協業 (パナソニック)
- ✓ 自己資本比率 7割台維持
- ✓ CSR報告書、EICC準拠宣言
- ✓ グループ行動規範開示
- ✓ ガバナンス基本方針策定、開示

各セグメントの中期方向感

主な実績 (~ 2017年度)

半導体

No.1製品強化

新技術とソリューション強化



- ✓ メモリ市場向けマルチチャックローバ
- ✓ 車載・電子部品向け取引拡大
- ✓ ダイシングブレードの販売拡大
- ✓ 難削材グラインダの販売拡大

計測

No.1製品強化

海外需要取り込み

新規市場創出



- ✓ 航空機関連取引の拡大
- ✓ 自動化用途で海外市場開拓
- ✓ 光計測製品 受注開始

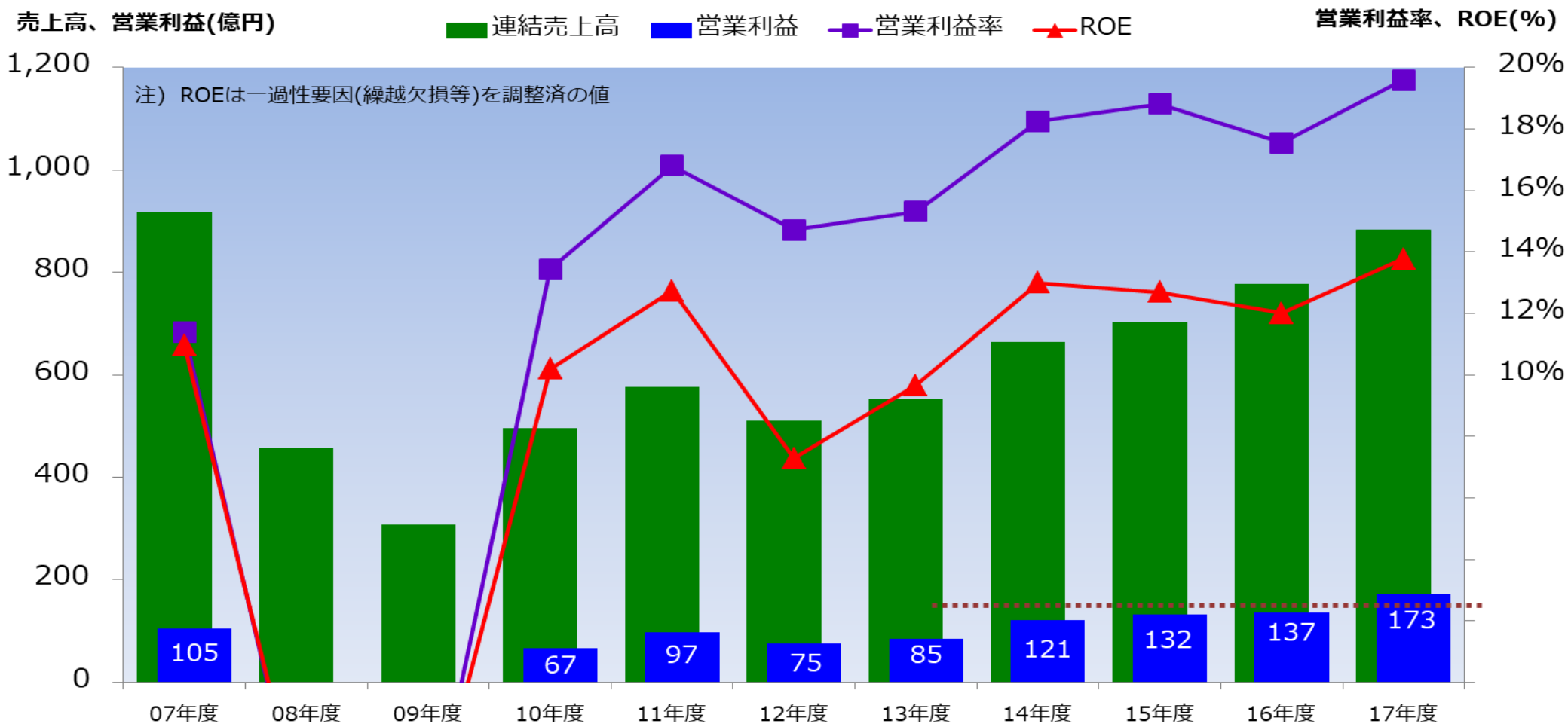
+α

精密技術を応用



- ✓ 専任部署設立
- ✓ PEファンド・VBへの出資

中期目標の進捗(3)



- ◆ 長期指標： ROE 10%以上 → 維持
- ◆ 中期目標(~18年度)： 営業利益 既往ピーク 150億円の更新 → 1年前倒し達成

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ **新 中期目標**
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ 質疑応答

世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく

理念を示すモットー:

→ **「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」**
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

コーポレートブランド:

→ **ACCRETECH**

“Accrete (共生)” と “Technology(技術)” の合成語

企業理念実現のための枠組み



当社事業構成の特徴

半導体

- ・ 強み:
- ・ 精密位置決め制御技術
- ・ 内製化
- ・ チャンス:
- ・ 新技術・新デバイス

計測

- ・ 強み:
- ・ 高精度・高分解能測定技術
- ・ 信頼性
- ・ チャンス:
- ・ 新分野・海外需要

- ・ バランスの取れた事業構成
- 異なる事業領域を有することによる
安定性(需要変動影響を吸収)

ネットワーク・通信を軸に新技術が発展、連鎖的な成長フェーズへ

IoT(モノのインターネット)

クラウドコンピューティング



VR/AR(仮想現実、拡張現実)



データ・人・モノのトラフィックが拡大



スマートフォン, 情報端末



自動運転・電装化



ファクトリーオートメーション



AI(人工知能), ビッグデータ



デジタル生産管理



ジェット機需要



半導体：新たな成長ステージ

- ネットワーク関連：メモリ、電子部品、センサ
- 車載関連：センサ、パワー、SiC基板
- 中国需要：投資本格化、新工場建設（～2019年）

計測：持続的な成長の継続

- 自動車：プラットフォーム革新、内燃機関 開発継続
- 工作機械：需要拡大に伴うゲージ需要，IoT
- 航空機：特に新興国の中型ジェット機 需要

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円
(2020年度迄に)

両輪にて達成

売上拡大
(1,100億円を目指す)

利益率向上
(営業利益率20%以上を目指す)

技術面

製品競争力強化、対象市場拡大

生産面

**生産キャパシティの拡充
効率改善 (自動化・省人化)**

利益率改善

**ERP導入による情報共有化促進
サービス (フィールド、エンジニアリング) , 消耗品売上の拡充**

中期目標達成





個別製品/技術への対応

プローバ

- デパート化戦略の継続 (デバイス・顧客に最適なプラットフォーム、オプションの提供)

ダイ・ブレード

- リューション構築・提供
- オプション機能拡大
- 次世代デバイス対応
- 新技術(レーザ, プラズマ)

研削装置

- 最先端テクノロジー対応 (TSV, 3D, FOWLP/PLP...)
- 新材料(SiC等)の展開



メモリ向けマルチチッププローバ



ダイサ・ブレード



ポリッシングライン



CMP



高剛性ライン



製品/ソリューションによる差異化と販路拡大



製品開発

- ハイエンド機 強化
- エントリー機, ゲージ類拡充
- 光学測定機器
ラインナップ° 拡充

ソリューション

- エンジニアリング, 保守, 受託
ビジネスの強化
- 自動測定機能
- 対応インターフェイス

販売活動

- 海外地域別戦略の遂行
- アプリセンター拡充
- 新業界開拓



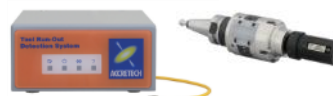
超高精度 真円度測定機



高精度 三次元座標測定器



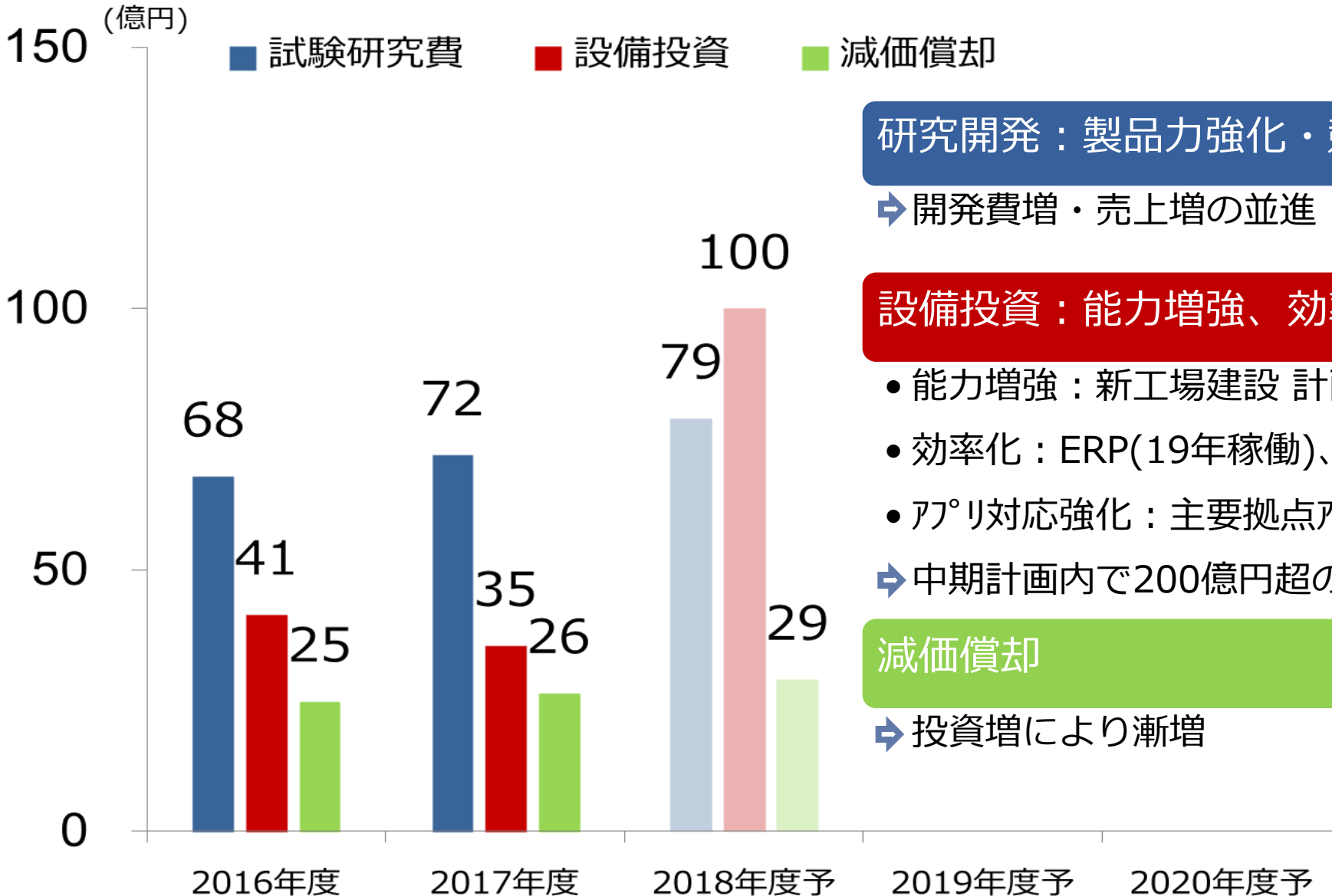
現場向け 粗さ測定器



ATC対応無線ボアゲージ



非接触 三次元粗さ・形状測定機
(ウェーハ専用モデル)



研究開発：製品力強化・競争力維持

⇒ 開発費増・売上増の並進

設備投資：能力増強、効率化等

- 能力増強：新工場建設 計画中
 - 効率化：ERP(19年稼働)、自動化投資
 - アプリ対応強化：主要拠点アプリケーションセンター
- ⇒ 中期計画内で200億円超の投資を計画

減価償却

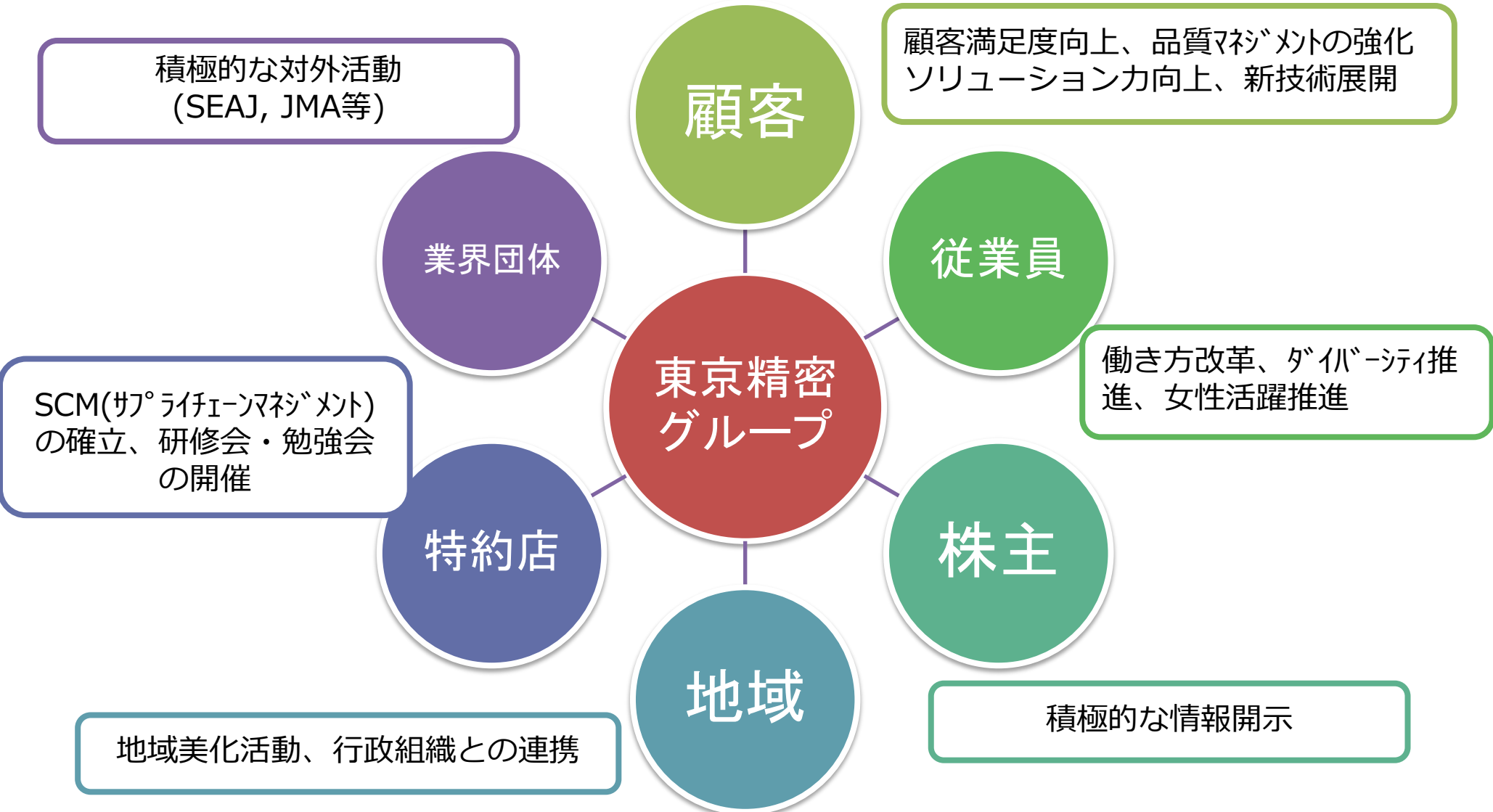
⇒ 投資増により漸増

- 財務健全性を維持しつつ、成長投資に注力
- 配当は、業績連動の利益配分を基本に、連結配当性向30%を目安に実施
- 18年度は、創業70周年記念配当(20円)実施、通期配当計画114円

1株配当推移



持続的可能な社会実現への取り組み (CSR活動)



Environment(環境)

- 環境考慮製品 : LCAを考慮した環境配慮型製品の開発
- 温暖化防止 : CO2排出量削減
- 資源削減 : 水使用量削減、廃棄物リサイクル率向上

Social (社会)

- 品質向上、作業安全 : 変更点管理プロセスの強化、QMS活動、事故率低減
- サプライチェーン : 当社方針に基づき、サプライヤと協力してESGの強化改善を実施
- 他 : 働き方改革(女性活躍推進等)、コンプライアンス、八王子/土浦市 アドプト活動

Governance(ガバナンス)

- グループ行動規範 : 全拠点への教育、浸透、見直し
- コンプライアンス : 遵守体制の構築、教育、見直し
- 情報セキュリティ強化 : 社内管理システム強化、点検体制、管理教育



次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 新 中期目標
- ◆ **2018年度業績予想**
- ◆ 質疑応答

半導体

- 足許受注は引き続き堅調
- 生産は部材調達の逼迫状態が続く
- スマートフォン部品向け装置の発注タイミング等が不透明で先行きが見通しづらい状況

計測

- 国内モノづくり需要は堅調さを維持
- 海外、特に中国の引合い増加に期待
- 自動化対応、エンジニアリング対応への引合増加を見込む

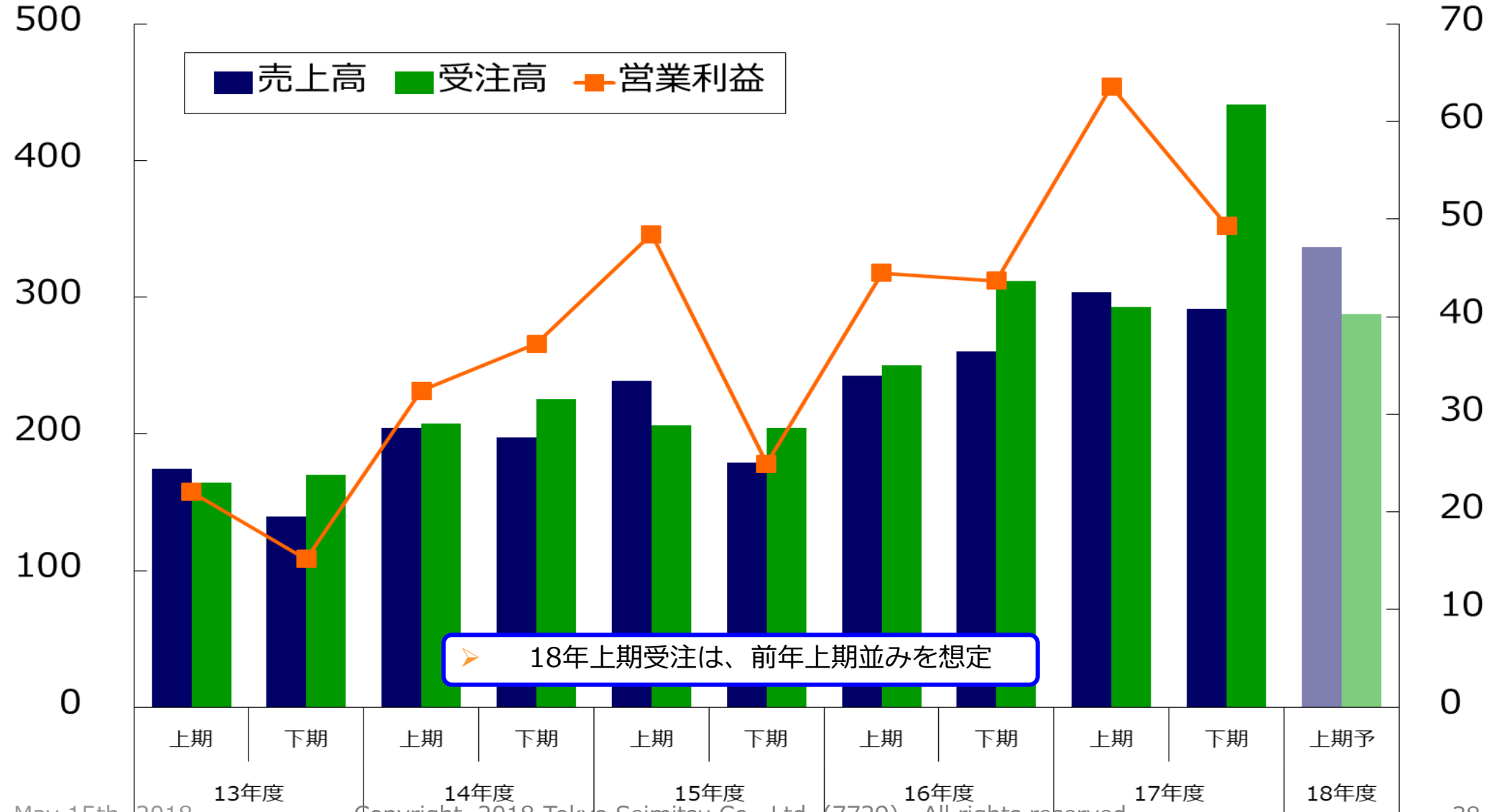
単位：億円（配当除く）

	2017年度			2018年度			
	上期	下期	通期	上期 予想	下期 予想	通期 予想	前年比
売上高	437	445	882	482	468	950	+8%
半導体製造装置	303	292	595	337	317	654	+10%
計測機器	133	154	287	145	151	296	+3%
営業利益	89	84	173	97	88	185	+7%
同率	20%	19%	20%	20%	19%	19%	-
経常利益	90	83	173	97	88	185	+7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	64	64	127	69	62	131	+3%
1株配当	92円			114円(普通配94円、記念配20円)			+22円

*2018年度は 創業70周年記念配当を実施予定

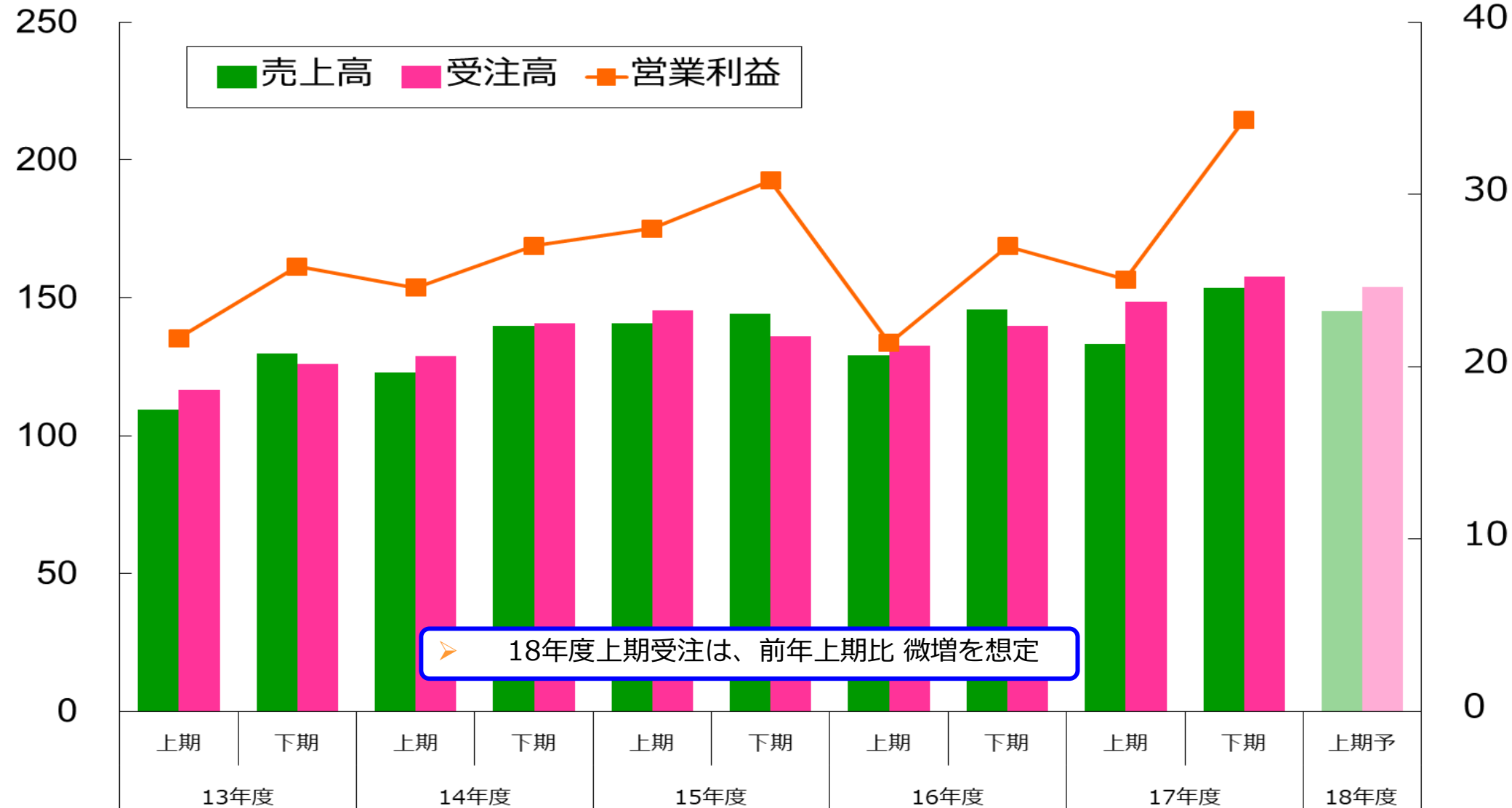
売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 新 中期目標
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ **質疑応答**



<http://www.accretech.jp/>